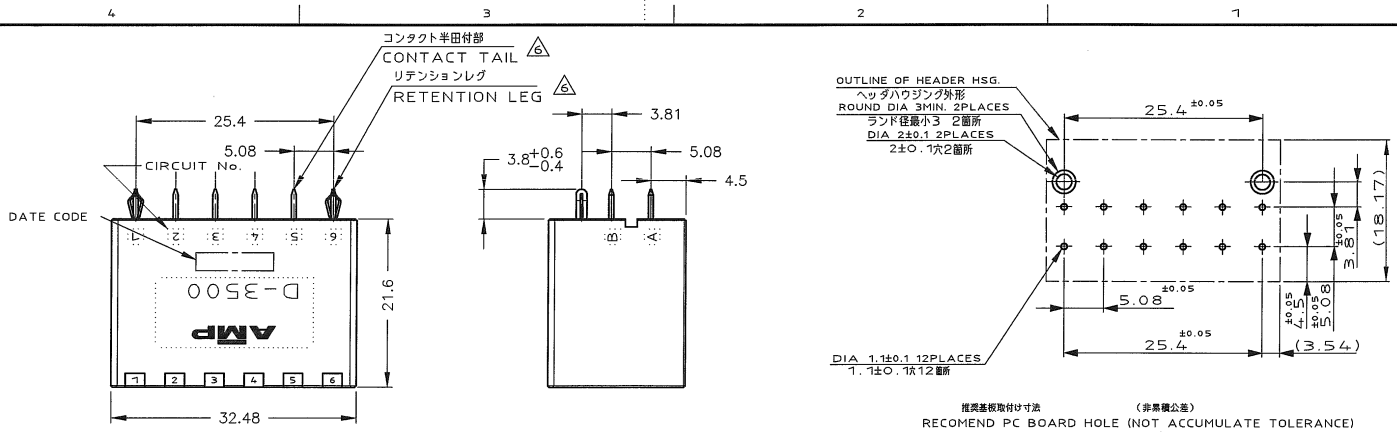
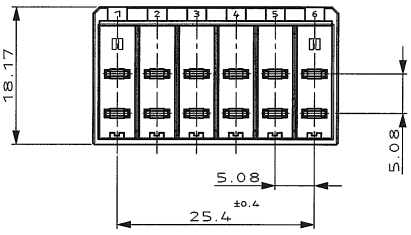


推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
RECOMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS;1.6±0.1
基板厚;1.6±0.1



NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC ,UL94V-0
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂 ,UL94V-0
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト接触部 : ニッケル下地の上に金めっき0.38μmMIN
3. めっき: コンタクト接触部 : ニッケル下地の上に金めっき0.76μmMIN
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:2.0 μm MINスズめっき
~~5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

6	4	-5
6	3	-3
6	2	316516-2
FINISH		型番 PART NUMBER

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	REVISED (FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03
A	REVISED (FJD0-0114-03)	TS	SM	25.APR '03
0	RELEASED FJ00-3261-95	NM	Y.I	10/24 '95

Copyright ©1995 年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics
Tyco Electoronics AMP K.K Kawasaki,Japan

社会電線断面積(WIRE RANGE)	mm?(AWG -)
被覆外径(INSULATION DIA.)	mm∅
材料(MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照	仕上(FINISH) (SEE NOTE) 注記参照
DR. 24 OCT 95 N.MATSUBARA	DE. 24 OCT 95 N.MATSUBARA
CHK. 24 OCT 95 Y.ISHIKAWA	APP. 24 OCT 95 S.MANABE

名称(NAME) DYNAMIC(D-3500) 12 POS. V HDR. ASS'Y

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.35
10を超え 30以下 : ±0.4
30を超え100以下 : ±0.45
角度 : ±3°

A3	LOC J	番号(No.) C-316516
尺度(SCALE) 2/1	REV. B	SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

NUMBER 316516
METRIC
三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
PROJ NO.395-623
単位: 特 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST
AMP-J REV.10/'83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor